



ASMP T 公布二零二四年第一季度業績

訂單對付運比率高於一

先進封裝推動新增訂單總額按季增長

集團業績概覽

集團財務概要：二零二四年第一季度

- * 銷售收入為港幣 31.4 億元(4.01 億美元)，按年-19.9%，按季亦-7.8%
- * 新增訂單總額為港幣 32.0 億元(4.09 億美元)，按年-9.8%，按季則+17.0%
- * 毛利率為 41.9%，按年+145 點子，按季則-40 點子
- * 經營利潤率為 7.6%，按年-425 點子，按季則+218 點子
- * 盈利為港幣 1.77 億元，按年-43.7%，按季則+134.5%
- * 每股基本盈利為港幣 0.43 元，按年-44.2%，按季則+138.9%

非香港財務報告準則計量¹

- * 經調整盈利為港幣 1.77 億元，按年-43.7%，按季則+132.1%
- * 經調整每股基本盈利為港幣 0.43 元，按年-44.2%，按季則+138.9%

二零二四年第二季度銷售收入預測

- * 將介乎 3.8 億美元至 4.4 億美元之間，以其中位數計按年-17.6%，按季則+2.2%

詳盡業績公告及投資者簡報可見於

<https://www.asmpt.com/zh-tw/investors/financials-results/>

(二零二四年四月二十四日，香港訊) — **ASMP T Limited** (「ASMP T」 / 「集團」 / 「公司」) (股份代號：0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬件和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二四年三月三十一日止三個月之季度業績。集團銷售收入達到預測的中位數。

¹ 於二零二四年第一季度及二零二三年第一季度皆無相應的非香港財務報告準則調整。有關非香港財務報告準則計量之詳情，請參閱最新業績公告中的「香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬」章節。

集團行政總裁黃梓達先生表示：「儘管行業處於下行周期，我們依然在二零二四年第一季度取得良好的表現，我謹此向全球團隊表示感謝。我們擁有獨特及廣泛的產品組合的堅實基礎，使集團保持堅韌和競爭優勢，能夠抵禦各種市場周期。集團的訂單顯著增長，尤其是來自我們的先進封裝解決方案，毛利率表現強勁。另外，集團的策略性措施及成本管控措施亦在穩步推進。」

集團二零二四年第一季度回顧

- 二零二四年第一季度的銷售收入為港幣 31.4 億元（4.01 億美元），達上一次發布的預測中位數。由於半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部銷售收入均下降，導致銷售收入按季下降 7.8%，再加上半導體持續下行周期，使半導體解決方案分部的下降幅度更大。表面貼裝技術解決方案分部佔集團總銷售收入約 56%，這突顯了集團獨有的廣泛產品組合的優勢，因為兩個分部遵循不同的業務周期。
- 新增訂單總額按季增長 17.0%，來自半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部，集團的訂單對付運比率在七個季度後升至一以上。半導體解決方案分部新增訂單總額按季增長主要由低基數效應推動，而表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額經過二零二三年下半年的放緩後，已開始趨於穩定，主要由汽車及工業終端市場所推動。
 - 特別是半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部對先進封裝解決方案的殷切需求是推動集團新增訂單總額增長的主要因素。
 - 半導體解決方案分部的先進封裝新增訂單總額增長主要來自互連解決方案包括熱壓焊接（「TCB」）、混合式焊接（「HB」）及覆晶（「FC」）高精確固晶等，主要受人工智能應用需求推動，而表面貼裝技術解決方案分部則來自系統封裝（「SiP」）先進封裝工具。
- 於二零二四年三月三十一日，集團的未完成訂單總額保持穩定，約為 8.49 億美元。
- 集團的毛利率按季微跌 40 點子至 41.9%，主要由於表面貼裝技術解決方案分部的毛利率下降，但部分已被半導體解決方案分部毛利率的增幅所抵銷。
- 集團的經營利潤率按季增長 218 點子至 7.6%，主要由於持續的成本管控措施及季節性因素導致營運費用下降所致。
- 集團的經調整盈利為港幣 1.77 億元，按季上升 132.1%。
- 集團的資產負債表保持穩健，於二零二四年三月三十一日的現金及銀行存款結存錄得港幣 52.5 億元。於二零二四年三月三十一日，集團的淨現金為港幣 27.5 億元。

集團的汽車應用繼續佔集團總銷售收入的最高比例，儘管汽車市場表現疲軟，集團表面貼裝技術解決方案分部於該市場的工具銷售收入仍按季錄得增長，而半導體解決方案分部的汽車解決方案亦受益於供應鏈的某些專門技術領域，例如能源及碳化矽模組，以及高端汽車智能車頭燈。

集團的先進封裝解決方案繼續成為集團的亮點，由於集團擁有業界最全面的先進封裝解決方案，可以服務多種應用的方案，因而處於領先地位以把握來自生成式人工智能及高性能計算（「HPC」）應用不斷增長的需求。以下是先進封裝的若干發展亮點：

- TCB:
 - 於第一季度繼續獲得來自垂直整合製造商及外判半導體裝嵌及測試客戶用於邏輯應用的訂單。
 - 集團於二零二三年下半年獲得 TCB 晶片到基底（「C2S」）應用的訂單，並已開始向領先晶圓代工客戶付運 TCB 工具。集團預期於第二季度及以後將獲得更多來自此領先晶圓代工客戶及其供應鏈合作夥伴應用於晶片到基底的 TCB 訂單。
 - 最近向該晶圓代工客戶交付了下一代超微間距晶片到晶圓（「C2W」）應用的 TCB 工具，以作共同開發之用，並對未來數季繼續獲得晶片到晶圓 TCB 訂單充滿信心。
 - TCB 因其高性價比，成為了 12 層、16 層及以上堆疊要求的首選解決方案。
 - 集團的 TCB 工具已於一間領先的高頻寬記憶體（「HBM」）公司投入生產，應用於 12 層堆疊。
 - 已向另一間高頻寬記憶體客戶交付了演示工具，未來還有更多工具亦在生產籌劃之中。
 - TCB 解決方案在精確度、處理薄或者大的晶片的能力以及深厚的工藝認知方面的優勢，隨著邏輯及高頻寬記憶體應用加快速採用 TCB，使集團處於有利地位。
- 混合式焊接：集團於第一季度獲得另外兩份邏輯應用的工具訂單，並有信心將於未來將能獲得更多混合式焊接訂單。
- 表面貼裝技術解決方案分部的先進封裝工具的新增訂單總額按季錄得增長，主要得益於其系統封裝工具，其需求主要由來自全球領先廠商的高端智慧手機和可穿戴設備，以及由個人電腦和伺服器相關應用的射頻模組所推動。

前景

集團預期二零二四年第二季度的銷售收入將介乎 3.8 億美元至 4.4 億美元之間，以其中位數計按年下降 17.6%，按季則上升 2.2%。按季輕微增長主要是由於半導體解決方案分部的銷售收入增加，但部份增長將被表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入減少所抵銷。

憑藉其獨有的廣泛產品組合，集團對其長遠前景及增長潛力依然保持樂觀，集團的信心亦得到包括汽車電動化、智能工廠、綠色基礎設施、5G/6G、物聯網、和於雲端、數據中心及人工智能邊緣裝置的人工智能增長的長期結構性趨勢所支持。從更廣泛的層面來看，這些結構

性趨勢與兩個關鍵領域的持續增長相互呼應：一方面，個別國家增加資本性開支加強本土化從而保護其供應鏈；另一方面，企業正為應對更多變的全球供應鏈，支持日益數碼化的互聯世界，做好準備。

關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬件及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及LED(顯示板)。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。詳細資訊請查閱ASMPT網頁<https://www.asmpt.com/>。

前瞻聲明

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻聲明。這些前瞻聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，不同因素可能導致實際結果與前瞻聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻聲明，而 ASMPT 不會承擔任何公開地更新或修訂任何前瞻聲明的義務。本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

新聞垂詢：

林詒源 (Lim Ee Guan)

企業傳訊總監

電話：+65 6450 1445

電郵：eg.lim@asmpt.com

代表 ASMPT：

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞 / 梁頌欣

電話：+852 2864 4812 / 2864 4862

傳真：+852 2527 1196

電郵：mandy.go@sprg.com.hk / vivienne.leung@sprg.com.hk